

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2024-15

## 成都高新发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,280,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### （一）公司简介

股票简称	高新发展	股票代码	000628
股票上市交易所	成都高新发展股份有限公司		
变更前的股票简称（如有）	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张月	王华清	
办公地址	四川省成都高新区九兴大道 8 号	四川省成都高新区九兴大道 8 号	
传真	(028) 85184099	(028) 85184099	
电话	(028) 85137070	(028) 85130316	
电子信箱	zhangyue@cdgxfz.com	wanghuaqing@cdgxfz.com	

#### （二）报告期主要业务或产品简介

功率半导体业务为公司战略转型确立的具备硬核技术的新主业，建筑业是公司目前第一大收入及利润来源，是公司打造强大功率半导体主业的坚实基础。

## 1、建筑业

### (1) 主要业务及其变化

#### ①概述

公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，业务区域主要位于成都地区。倍特建安承揽业务主要采用施工总承包与工程总承包模式（EPC 模式），通过竞标形式获得。报告期内，公司紧紧抓住成都高新区全力推进新经济活力区、电子信息产业功能区、天府国际生物城、交子公园金融商务区和未来科技城全域五大产业功能区建设的巨大机遇，大力提升建筑施工业务规模和效益，在成都高新区五大产业功能区建设的实施阶段，倍特建安紧密围绕其建设需求，整合外部资源，联合多家业内知名建筑设计院，以 EPC 模式陆续承揽并顺利实施多个重大优质项目，承接业务量保持稳健增长，经营业绩稳定增长。2023 年，倍特建安荣获“2023 年度成都市建筑业先进企业”等荣誉，承建的项目先后斩获了四川省建筑业新技术应用示范工程、四川省结构示范工程、成都市优质工程“芙蓉杯”等荣誉，并上榜四川省首批智能建造试点项目。公司将在持续服务于成都高新区建设的同时，在管理、人员等匹配情况下稳妥拓展区外业务，抓住城市产业升级建设机遇，探索工程建设与先进制造技术、新一代信息技术深度融合发展的潜力与空间，提高自身核心竞争力和创新能力，不断提升建筑业务收入规模和利润水平，将其打造为公司的业务发力点和重要利润支撑，为公司拓展具有发展前景的战略新兴产业业务打下坚实基础。

截止 2023 年 12 月 31 日，倍特建安通过工程总承包与施工总承包模式承揽的累计已签约未完工订单达 149 个，金额约 319.39 亿元，为公司以后年度的利润来源提供了可靠保障。

#### ②业务模式及风险

模式类型	模式描述	特有风险
施工总承包	建设方将全部施工任务发包给具有施工承包资质的建筑企业，由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务。	资金风险：房建项目居多，故受房地产市场整体环境波动影响较大，建设方资金链出现问题则给施工方带来工程款回收困难、资金压力增大、工程成本增加等经营风险； 盈利风险：准入门槛较低，恶性竞价剧烈，项目利润率较低。
工程总承包（EPC模式）	工程总承包企业依据合同约定，对建设项目的的设计、采购、施工、试运行完成全过程或若干阶段的承包任务。	全过程总控风险：工程项目建设周期长、投资多，金额大、技术要求高，系统复杂的生产建设过程，存在大量的不确定因素风险。在存在联合体内部协调机制的各种风险，比如设计与施工分离导致投资增加风险、建设进度工期风险等。

报告期内，倍特建安新承接项目中工程总承包项目金额占新签合同金额的 88.62%，为公司建筑业现在的主要业务模式。工程总承包项目具有节约项目工期、把控项目总造价、提高施工图的设计质量及施工质量、更有利于提升项目盈利水平的优势，倍特建安通过承接工程总承包项目将逐步提高建设项目周期中的前端设计优化水平，统筹协调整合各类优质资源，提升毛利率水平，持续提升公司核心竞争力。

### (2) 融资情况

报告期内，公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作，不断增加公司授信额度，并开展供应链金融，积极拓宽多种融资渠道，确保公司生产经营的资金需求。该部分信息具体详见本报告财务报告部分“财务报表附注”中“五、24 短期借款、32 一年内到期的非流动负债、34 长期借款”。

### (3) 质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

#### □执行质量标准和质量控制体系

GB/T19001 -2008《质量管理体系--要求》

GB/T50430-2007《工程建筑施工企业质量管理规范》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》

GB/T24001-2004《环境管理体系—要求及使用指南》

倍特建安 2009 年通过国际质量体系 ISO9001 认证以来，每年均通过北京中建协认证中心有限公司的监督评审。

#### □质量控制措施

倍特建安主要采取的质量控制措施包括：明确“过程精品、业主满意”的质量方针，制定质量目标，并将目标层层分解，做到质量责任明确、职权落实到位。建立完善的质量保证体系，配备完整、高素质的项目管理人员，强化“项目管理，以人

为本”的指导思想。开展全面质量管理，严格过程控制和程序控制，加强施工工艺质量控制，做到“标准化、规范化、制度化”。严格执行样板制、三检制、工序交接制、质量检查验收制等。建立以总工程师、技术部以及项目技术负责人组成的技术管理体系，施工前编制实施性施工方案，加强施工方案的评审，严格审核其工艺和顺序，确保施工质量。利用计算机进行项目管理和质量管理，强化质量检查和验收，加强质量管理的基础性工作。加强图纸自审、会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程的施工质量。严把材料（包括原材料、成品、半成品）和设备出厂质量关、进场质量关。建立施工机械管理制度和各种机械设备的操作规程，对施工机械做到“定人定机”的管理，保证现场机械始终处于受控状态。加强影响工序质量因素的控制来实施施工过程中的质量控制，对关键工序和重要部位，根据工艺本身的特殊要求，设置质量控制点，通过对质量控制点的监控确保工序质量。做好施工测量及试验工作。测量的原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。做好施工技术文件、资料的整理工作。加强工序验收手续，杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷。施工过程中发现不合格品，应立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。工程完工后，由项目部成立交工验收领导小组，组织各专业技术人员，会同业主代表、监理等单位，对工程进行最终的检验和验收。

### ③整体评价

倍特建安建立的质量控制体系运行是有效的，符合国际质量体系 ISO9001 认证要求。

报告期内，倍特建安通过 PDCA 科学管控实现项目全面质量管理，未发生重大质量事故。

### （4）安全生产制度的运行情况

报告期内，倍特建安高度重视安全生产工作，坚守安全红线意识。公司全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，围绕安全生产十五条内容，按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府和成都高新区党工委管委会重大决策部署，践行安全发展理念，严格执行安全生产相关法律法规和规章制度，按照狠抓安全生产措施落实，提高工程施工安全生产管理、风险防控及应急处置能力，为公司科学健康发展保驾护航。

报告期内，倍特建安严格按照安全生产制度规定操作运行，未发生重大安全事故。

## 2、功率半导体业务

公司持续深耕功率半导体业务，搭建功率半导体事业群，强化市场化机制运营，增强功率半导体业务发展动力。功率半导体事业群目前包含公司子公司成都森未科技有限公司（以下简称森未科技）、成都高投芯未半导体有限公司（以下简称芯未半导体）以及新设全资子公司成都电研科技有限公司（以下简称电研科技）。

森未科技的定位是在功率半导体领域专注 IGBT 等功率半导体器件的设计、开发和销售，掌握国际主流 IGBT 芯片设计技术和加工工艺，以通用产品支撑规模，以高端产品实现高附加值。目前森未科技处于功率半导体产业链中上游，面向客户提供 IGBT 器件、IGBT 检测方案、IGBT 应用方案。

作为公司打造 Fab-Lite 模式的重要载体，芯未半导体定位是功率半导体器件及组件特色产线建设的主体，报告期建设功率半导体器件局域工艺线和高可靠分立器件集成组件生产线，业务方向是为各领域/市场客户提供 IGBT 特色高端定制化模块及配套组件代工制造服务，主要面向新能源车、新能源发电（光伏/风力）及工控领域，通过产线建设旨在搭建企业一体化制造、测试平台，实现从芯片特色工艺到模块、组件的一站式中试、量产能力，推动产品快速高效迭代，充分挖掘 IGBT 产品能力和潜力，服务产业链上下游客户。功率半导体器件局域工艺线注重超薄晶圆和高能注入等特色工艺研发攻关，是 IGBT 产品核心竞争力的重要工艺支撑，公司已充分掌握上述超薄晶圆和高能注入等特色工艺所需的核心技术。2023 年 10 月 13 日，芯未半导体项目一期通线仪式顺利举行，标志着一期项目全面通线投产，芯未半导体项目是成都首个功率半导体代工平台和成都规模最大的功率半导体中试平台，主要为功率半导体设计和制造企业、终端应用企业等提供从晶圆背面加工-模块封测代工-组件集成代工的一站式代工服务。本次通线投产后，将形成约 120 万只/年功率模块生产能力。根据成都高新区科技创新局公布的《成都高新区 2023 年第二批拟认定中试平台名单》，芯未半导体获成都市高新区“芯未功率半导体中试平台”认定并成功入围 2023 省经信重点工业项目。

新设全资子公司电研科技则定位为功率半导体研究院，专注功率半导体技术研发，聚焦于服务公司功率半导体业务的中长期科研和项目孵化，以及技术和人才的培育。

未来，随着公司功率半导体研究院的不断发展以及功率半导体器件局域工艺线和高可靠分立器件集成组件生产线的建设完成，电研科技与森未科技将协作进行功率半导体研究，强化技术预研和技术储备，并通过芯未半导体实现量产及成果转化；森未科技将充分利用芯未半导体的产能加快客户订单交付，打造差异化、特色化产品以提高市场竞争力；芯未半导

体将优先响应森未科技和电研科技的转化需求，将其作为新增产能消化的有力支撑，并且根据不同模式和领域客户类型，向行业提供差异化制造（高附加值）及综合服务。公司将拥有 IGBT 等功率半导体芯片到集成方案的全链条研制能力，通过持续不断加强自身在核心工艺、差异化制造的能力建设，结合外部相对标准化的晶圆和封测代工资源，实现产品快速迭代、规模化生产，以相对较低的投入构建更高的技术壁垒，兼顾生产效率及产品竞争力的提升。

根据前述定位和发展路径，报告期内，森未科技结合自身能力和优势，持续强化研发设计能力，推进 IGBT 功率半导体国产化进程，联合芯未半导体打造 Fab-lite 经营模式，并且以市场为导向，深耕功率半导体细分应用领域，重点推进在工控、新能源领域下游应用市场。2023 年 9 月新设的功率半导体研究院电研科技，将持续推进功率半导体技术人才的引进培育等工作。芯未半导体完成封装一期通线，晶背设备全部到位，进入联调阶段。

#### （1）森未科技

##### ①产品情况

森未科技 IGBT 器件系列产品全面采用沟槽栅+场截止技术，覆盖 600-1700V 以及低、中、高频应用领域，对标全球 IGBT 龙头英飞凌的同类芯片产品。其中，模块提供多种封装形式，H 类、D 类、F 类、B 类等，可实现与国际主流厂商的 PIN TO PIN 替换；单管提供 TO-220F、TO-247、TO-247plus、TO-264 等多种封装形式。产品应用于工业变频、高频感应加热、特种电源、新能源汽车、新能源发电市场。报告期，森未科技已成功发布多款第七代沟槽栅+场截止技术产品，具备更低损耗、更高性能、更高密度，成功应用在充电桩，光伏逆变器市场；积极布局第三代功率半导体，成功发布 SiC SBD 产品，并向车用 SiC Mosfet 系列产品延展。

##### □IGBT 检测方案

IGBT 检测方案依托于森未科技建立的 IGBT 芯片和器件检测分析平台（成都市高新区“IGBT 公共技术平台”），平台主要设备包括芯片全自动制样设备、高倍光学显微镜、扫描电子显微镜、晶圆探针台、功率器件曲线追踪仪、功率器件动态测试机等，涵盖芯片微观结构、芯片/晶圆静态电学参数、器件静态参数、动态参数、绝缘耐压等一系列项目测试，并且能够开展器件失效分析和逆向分析的整套流程。

森未科技以团队自主开发为主，不断拓展 IGBT 器件应用测试平台。报告期，森未科技新增开发 IGBT 无功老化测试平台，形成了通用型老化测试平台（包括功率循环测试平台和高温反偏平台等）、IGBT 无功老化测试平台、80KW 逆变并网及无功测试平台、变频器对拖测试平台、感应加热类应用测试平台等一系列针对不同用户和应用场景的测试平台，持续保障器件在终端客户的使用和优化，不断追求产品性能和可靠性的精益求精。2023 年 10 月，森未科技先进功率半导体应用检测中心（以下简称“检测中心”）正式通过中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）认可并取得了资质证书，这是检测中心快速发展的重要里程碑，检测中心已具备国家及国际认可的管理水平和专业检测能力，能够为客户提供国际水平的优质的服务。

##### ③IGBT 应用方案

森未科技测试应用团队成员均为行业器件应用的资深专家，具备十年以上的 IGBT 器件现场应用经验，目前已有多个领域的成熟应用方案，也可根据客户工况，定制开发产品应用方案，主要涵盖了通用变频器解决方案、感应加热解决方案、新能源&高频电源解决方案。报告期内，森未科技应用团队针对下游细分行业不断拓展应用方案。在充电桩领域，开发了应用测试方案，可验证器件应用匹配性；在储能领域，开发了充放电老化测试方案，可验证器件在极限情况下稳定情况；在新能源车领域，开发了水冷测试方案，可根据负载调整参数，验证器件输出能力。

##### ④下游应用市场拓展情况

森未科技拥有一支“一体两翼”的产品经营团队，以产品线经营为主体，市场产品中心和营销中心为两翼，建立了将客户需求快速有效地转化成产品的新产品开发机制。团队核心成员不仅有掌握公司技术参数和产品性能的产品管理专家和产品应用专家，还引进了多名具备丰富经验的销售管理人员和产品经理，不断强化直销队伍建设与人才培养，并持续拓展和引进行业外围资源，通过发展代理、经销商、渠道商的模式，借助行业资源，实现优势互补、强强联合，提升行业知名度。2023 年，在巩固既有客户基础之上，不断加深行业拓展，客户数量和客户质量均比上年同期得到显著提升，产品被广泛的应用在：通用变频器（1200V IGBT）、高压变频器（1700V IGBT）、有源电力滤波器（APF）、焊接电源、激光电源、光伏、储能、新能源汽车、电池化成与检测设备、静止无功发射器（SVG）、充电桩、变频空调等各应用领域，在工业控制领域、新能源汽车以及风光储市场三大主要市场不断丰富产品面：

a.工业控制应用领域。森未科技拥有系列化最全的产品，可完全兼容国际一线主流品牌的各类封装，产品涵盖 650V、

1200V、1700V 三大类系列，被广泛的应用在工业控制应用领域的工业变频、伺服和特种电源应用场景。该系列产品具有 Trench+FS 技术、高短路耐量、低损耗等特点。目前，该系列产品目前的国内应用客户群体不断增加，并有部分海外客户验证和测试通过，有望替代国际一线主流品牌。

b.新能源汽车应用领域。新能源汽车作为 IGBT 最重要的市场之一，2020 年森未科技推出的 1200V IGBT 模块就已在深圳新能源车客户的电动车上进行了急加速、急减速、长时间爬坡等共计上万公里的整车测试并顺利通过所有测试项目。森未科技自有的 1200V 450A/600A 等 IGBT 模块也已陆续投入新能源车市场。同时，在 OBC、PTC、空调压缩机、主驱等场景，森未科技自有的 IGBT 产品已经通过了全球知名的新能源车厂的认证和测试。森未科技也将持续开展车规级 IGBT 的研发与应用，拓展新能源汽车市场，提升新能源汽车产业链的业务规模。

c.风光储应用领域。IGBT 作为光伏、储能逆变器等新电源发电领域的核心器件，森未科技在 2021 年已推出高功率密度系列产品，瞄准光伏逆变、光伏储能等市场，并作为公司重点项目持续投入研发。目前，公司研发的 650V-1200V 高频 IGBT 以及三电平系列模块产品通过国内光伏储能头部企业的验证，已经获得批量订单，被广泛应用在 50KW、100KW、125KW、150KW、200KW、215KW、250KW 等主流机型，并将推出更大功率应用产品。

综上，森未科技坚持以市场和客户需求为导向，链接行业资源，持续通过技术创新和产品迭代，提供满足客户需求的具有市场竞争力的功率半导体产品。通过为客户提供优质的服务并依靠自身人才、技术等基础优势的长期积累，成熟运用芯片的核心设计技术，成功实现了产品形态延伸，形成了多类型 IGBT 产品布局。同时通过建立 IGBT 芯片和器件检测分析平台并取得 CNAS 认证，具备了国家及国际认可的管理水平和专业检测能力，为客户提供国际水平的优质的服务，满足客户对产品性能及质量的要求。产品与服务继续纵深拓展工业控制应用、新能源汽车应用以及风光储应用三大应用市场，产品销售覆盖地域已分布至华东、华南、华北、西南等地，产品出口至韩国、日本、新加坡、德国、印度等国家及台湾地区，渠道和品牌效果开始逐步展现。

## (2) 芯未半导体

报告期内，芯未半导体持续推进功率半导体器件及组件特色产线建设，一期项目已正式通线投产。晶背设备全部到位，进入联调阶段。芯未半导体产线建设项目作为成都首个功率半导体代工平台，也是成都规模最大的功率半导体中试平台，将主要为功率半导体设计企业、制造企业、终端应用企业等提供从 IGBT 晶圆背面加工-模块封装-集成组件的一站式代工服务。

### ①晶背工艺

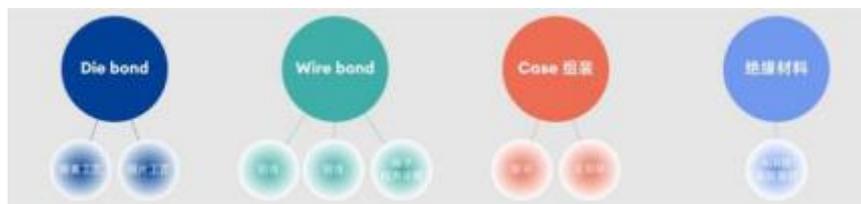
芯未半导体致力于为客户提供稳定、可靠、先进的 IGBT 超薄片代加工服务；工艺平台引进国际先进的生产设备，如背面太鼓研磨减薄、背面离子注入、金属溅射沉积、CP 测试及相应的量测检测设备等等。旨在为客户提供丰富的 IGBT、MOS 等基于超薄工艺的代工服务。未来芯未半导体代工的产品将涉及汽车电子、智能通信设备、工业、消费电子和医疗器械等领域，致力于打造成全球领先的功率半导体超薄片代加工平台。

## IGBT 晶圆背面线工艺和测试能力



### ②模块封装

采用业界先进的功率半导体封装工艺，可以实现包括 IGBT、SiC 等功率芯片的集成封装，包括真空焊接、键合、清洗、端子超声、插针、灌胶以及测试等，技术参数达到业界领先水平，可根据客户需求定制工艺研发和大规模生产方案。



### ③集成组件

整合新能源产业链上下游资源，提供新能源产业的关键器件、设备、系统等全流程产品，并为客户提供新能源产业应用场景的全套系统解决方案。

### (3) 电研科技

2023 年 10 月成立电研科技（功率半导体研究院），旨在通过引进培育产业化专业人才团队，统筹功率半导体业务新技术、新产品及其应用方案的研究。报告期内，已完成来自北京大学、美国俄亥俄州立大学、中科院、电子科大等十余名高科技研发人才的引进工作。电研科技积极链接科研院所资源，打造产学研创新平台，已启动与清华大学、中科院、电子科大的校企合作，将学校的师资和科研技术优势转化为公司的科研优势，建强研发实力，开展由清华、北大及复旦等知名高校博士牵头的核心研发课题。

## (三) 主要会计数据和财务指标

### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	13,612,432,347.72	13,677,871,066.54	-0.48%	10,828,274,340.73
归属于上市公司股东的净资产	2,107,137,625.68	1,751,125,495.04	20.33%	1,558,202,228.37
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	8,008,118,403.35	6,570,599,836.21	21.88%	6,611,796,782.29
归属于上市公司股东的净利润	365,937,536.58	199,070,118.38	83.82%	163,348,056.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,593,557.47	133,612,602.82	50.88%	135,104,239.70
经营活动产生的现金流量净额	-527,288,751.94	139,660,008.16	-477.55%	458,904,109.68
基本每股收益（元/股）	1.039	0.565	83.89%	0.464
稀释每股收益（元/股）	1.039	0.565	83.89%	0.464
加权平均净资产收益率	18.98%	12.03%	6.95%	10.65%

### 2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	908,824,375.56	1,923,432,222.37	1,673,627,134.23	3,502,234,671.19
归属于上市公司股东的净利润	31,451,902.84	61,861,254.66	160,553,981.89	112,070,397.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,596,446.07	61,455,775.56	14,707,833.24	94,833,502.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,348,992,209.78	-31,805,291.18	-556,160,599.88	1,409,669,348.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## (四) 股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,133	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.88%	172,207,860	145,285,560	不存在质押或冻结情况		
成都高新未来科技城发展集团有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况		
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况		
何鹏翔	境内自然人	1.42%	4,989,000	0	不存在质押或冻结情况		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	4,385,025	0	不存在质押或冻结情况		
唐杰晖	境内自然人	0.99%	3,500,000	0	不存在质押或冻结情况		
章建平	境内自然人	0.90%	3,181,200	0	不存在质押或冻结情况		
成都产业投资集团有限公司	国有法人	0.89%	3,120,000	0	不存在质押或冻结情况		
江苏银行股份有限公司－诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	3,070,408	0	不存在质押或冻结情况		
包日来	境内自然人	0.77%	2,727,922	0	不存在质押或冻结情况		
上述股东关联关系或一致行动的说明		成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

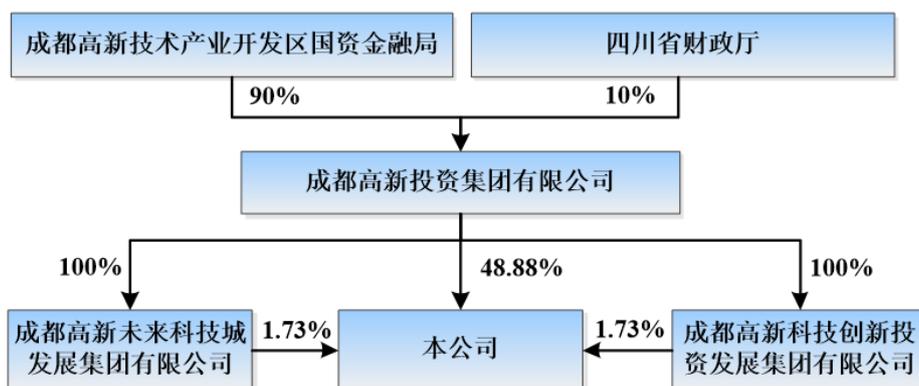
适用 不适用

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## （五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

1、报告期，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团有限公司、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）、海南云辰合业科技合伙企业（有限合伙）（2024 年 1 月平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）已更名为“海南云辰合业科技合伙企业（有限合伙）”）合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限公司 70.00% 的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司第八届董事会第六十九次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于 2023 年 10 月 19 日披露了相关文件。2023 年 11 月 11 日，公司就 2023 年 10 月 19 日收到的深交所上市公司管理一部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 25 号）进行了回复并披露了《成都高新发展股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函〉回复的公告》《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。后续根据相关法律法规要求，公司分别于 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 18 日披露了本次交易的进展情况。（具体公告详见 2023 年 9 月 27 日、10 月 19 日、11 月 11 日、11 月 18 日、12 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。报告期后，公司分别于 2024 年 1 月 17 日、2 月 19 日、3 月 19 日披露了本次交易的进展情况（具体公告详见 2024 年 1 月 17 日、2 月 19 日、3 月 19 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。截至本报告披露日，本次交易正在推进中。

2、经公司第八届董事会第三十四次临时会议、2021 年第二次临时股东大会、第八届董事会第六十五次临时会议审议通过，公司、公司子公司成都倍特投资有限责任公司和成都高投资产经营管理有限公司拟将合计持有的倍特期货有限公司 55% 股权转让给成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子新兴金融投资集团股份有限公司，公司收到了中国证监会出具的《关于核准倍特期货有限公司变更股权、实际控制人的批复》（证监许可〔2023〕1797 号），核准倍特期货有限公司股权变更、核准倍特期货有限公司实际控制人变更为成都交子金融控股集团有限公司（相关公告详见 2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 30 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。2023 年 9 月 7 日，上述股权转让事项已完成工商登记。

3、公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已经公司第八届董事会第四十八次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、2022 年第一次临时股东大会、第八届董事会第五十九次临时会议、第八届监事会第四次临时会议、第八届董事会第六十次临时会议、第八届监事会第五次临时会议、第八届董事会第六十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会议审议通过，募集资金扣除发行费用后将用于成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目及补充流动资金。（相关公告详见 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 6 日、2022 年 12 月 14 日、2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 27 日、2023 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。2023 年 7 月，公司取得中国证监会出具的《关于同意成都高新发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1600 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请（相关公告详见 2023 年 7 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。截至披露日，相关工作正在推进过程中。

4、公司曾就全资子公司倍特建安与成都嘉华美实业有限公司（以下简称嘉华美公司）因《华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》纠纷，向成都仲裁委员会提起仲裁申请及其仲裁结果，以及向四川省成都市中级人民法院申请强制执行并立案执行等情况进行了公告（相关公告详见 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 26 日、2022 年 5 月 10 日、2022 年 5 月 19 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。报告期，为尽快推动嘉华美公司履行生效法律文书确定的义务，公司子公司倍特建安在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解，并签订了《执行和解协议书》。倍特建安已收到四川省成都高新技术产业开发区人民法院《执行裁定书》、《案款分配决定书》和执行案款 3.5 亿元。（相关公告详见 2023 年 2 月 24 日、7 月 15 日、8 月 16 日、12 月 13 日、12 月 28 日的《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。报告期后，公司收到成都高新区人民法院执行案款 132,915,405.47 元，倍特建安就其承建的华惠嘉悦汇广场 ABC 标段项目的应收工程款 482,915,405.47 元已全额收回。（相关公告详见 2024 年 1 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

成都高新发展股份有限公司董事会

董事长：任正

二〇二四年三月二十六日